

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 6 月 2 日 (2005.6.2)

【公開番号】特開 2004-31731 (P2004-31731A)
【公開日】平成 16 年 1 月 29 日 (2004.1.29)
【年通号数】公開・登録公報 2004-004
【出願番号】特願 2002-187256 (P2002-187256)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 K 3/46

【 F I 】

H 0 5 K 3/46 S

H 0 5 K 3/46 B

【手続補正書】
【提出日】平成 16 年 8 月 17 日 (2004.8.17)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 5 7
【補正方法】変更
【補正の内容】
【 0 0 5 7 】

(2) また、本実施形態の製造方法では、積層された金属箔 8 3 , 8 4 のエッチング (即ちサブトラクティブ法) により、配線層 3 1 , 3 2 , 5 1 , 5 2 のパターン形成を行うようにしている。よって、アディティブ法によりパターン形成を行う場合に比べて、短時間かつ低コストで上記構成の積層樹脂配線基板 1 1 を製造することができる。